

第43回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2023年7月12日（水）13:00～16:05

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 尾形 繁行（OKI ネクステック株式会社）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『液相析出法による密着層を形成したガラス基板への銅めっきプロセス』（40分）

.....○速水 雅仁¹, 妹尾 駿作¹, 白濱 祐二¹, 長尾 敏光², 佃 真優²
(¹パナソニック環境エンジニアリング株式会社, ²奥野製薬工業株式会社)

13:50～14:30

『電磁波シールドパッケージにおけるモールド樹脂とスパッタ法による金属膜の密着性』（40分）

.....○本間 荘一^{1,2}, 志摩 真也¹, 高野 勇佑¹, 西川 宏² (¹キオクシア株式会社, ²大阪大学)

14:30～14:45 休憩

司会 藤野 純司（三菱電機株式会社）

14:45～15:25

『摩擦攪拌プロセスを利用したセラミックス板上への金属の接合』（40分）

.....○園村 浩介（大阪産業技術研究所）

15:25～16:05

『ダイヤモンドと異種材料の接合による高放熱性能を持つパワーデバイスの開発
と高出力実現』（40分）

.....○梁 剣波¹, 重川 直輝¹, 大野 裕² (¹大阪公立大学, ²東北大学)

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会